



Orbotech Infinitum™ 10/10XT

卷對卷成像新時代



Orbotech Infinitum 10/10XT

Orbotech Infinitum 10/10XT 是創新型軟板卷對卷量產直接成像解決方案。

配備 KLA 突破性的 DDI™ (滾筒式直接成像) 技術，Orbotech Infinitum 10/10XT 可實現最佳板材處理和高速成像，提供高良率和產能。

這一全新解決方案採用 KLA 經市場驗證的 LSO™ (大鏡面掃描光學) 技術和 MultiWave Laser™ (多波長雷射) 技術，即使在最薄的軟板板材上也能實現卓越的線路品質和高精度。

Orbotech Infinitum 10/10XT 是一體式、緊湊、封閉的創新解決方案，可確保卓越的性能和最佳效率。



優勢

優化的板材處理及高良率

- 基於滾筒的創新解決方案，實現最佳板材處理
- 可控的低張力板材移動，防止變形
- 整合式自動清潔機制，有效去除異物

快速產出，高產能

- 通過在轉動的滾筒上連續曝光實現高速成像
- 高成像效率，動態靶點捕捉
- 通過快速料號和卷材更換，最大限度提高有效執行時間

出色的成作品質

- 連續曝光和高景深 (DoF) 帶來極精細的線路結構和均勻度
- 相容多種感光材料和製程，可同時進行多波長成像
- 板材變形自動補償機制實現高對位精度

體積小，使用介面友善

- 一體式解決方案，占地面積小，極高的效率及清潔度
- 高度直觀、使用者友善的人機介面，確保平穩運行
- 採用獨特設計，便於卷材更換



Technologies



DDI™ Technology

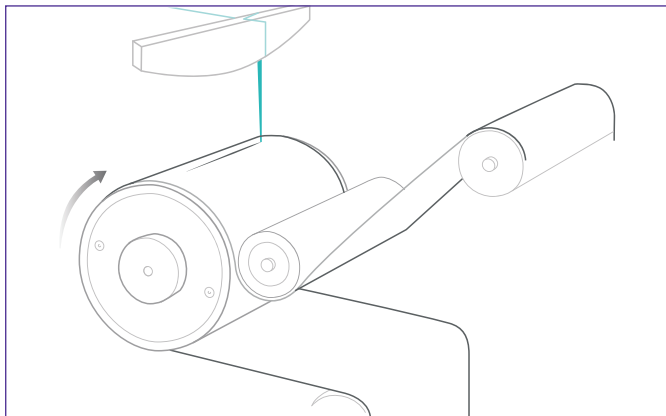


LSO™ Technology



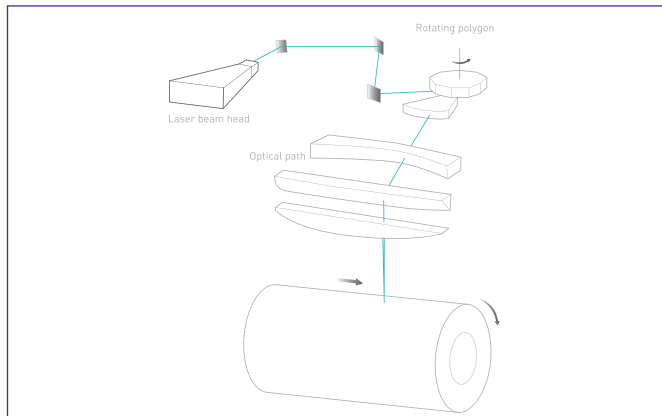
MultiWave Laser™ Technology

高產能滾筒式卷對卷直接成像



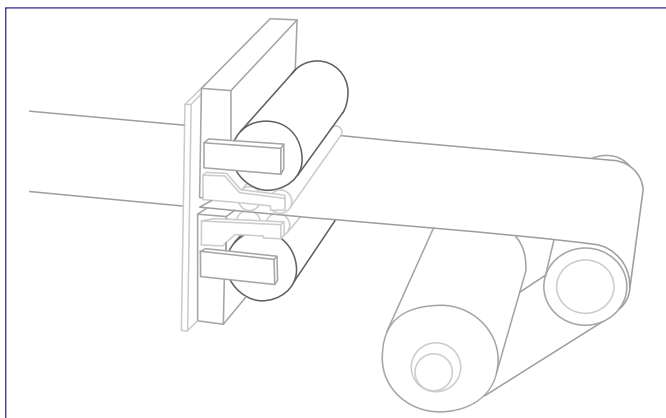
採用 KLA 全新的 DDI™ (滾筒式直接成像) 技術，實現持續、單向和恆定的滾筒旋轉，確保高產能和完美的板材處理

出色成像品質



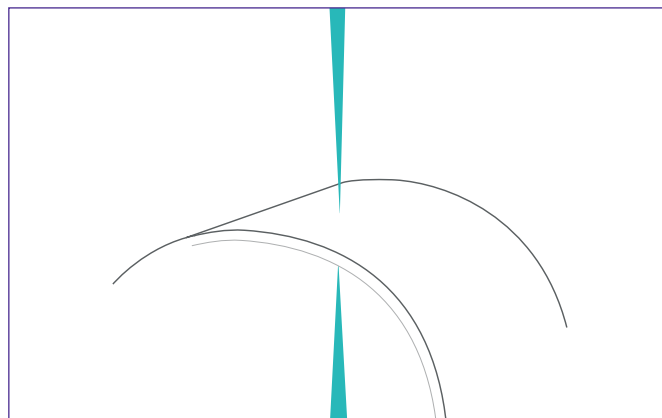
採用 KLA 的 LSO™ (大鏡面掃描光學) 技術，單次掃描即可實現卓越的線路結構

高清潔度



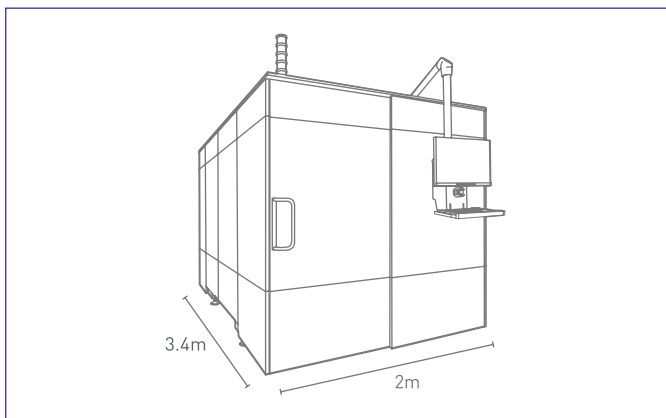
整合式自動清潔機制

高線路均勻度



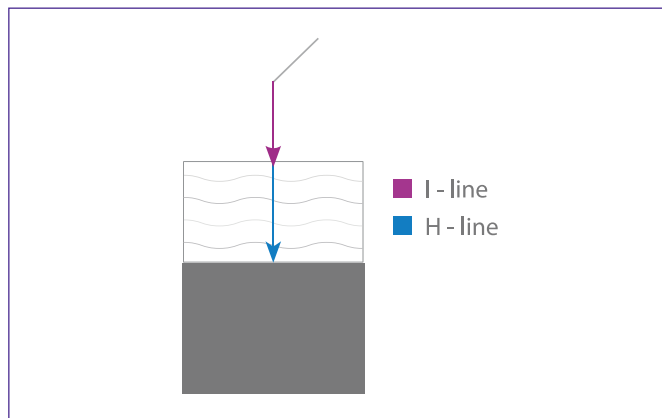
高景深 (DOF) 實現線路精度和均勻度

一體式緊湊設計



一體式解決方案，占地面積小，效率高

支援多種感光材料



採用 KLA 的 MultiWave Laser™ (多波長雷射) 技術，兼容多種感光材料和製程

規格

	Orbotech Infinitum 10	Orbotech Infinitum 10XT
卷材寬度	250 - 260mm	250 - 520mm
最大成像寬度	260mm	520mm
最小線寬/線距*	10/15µm	
對位精度 (FtG)	±10µm	
成像能量範圍	10 - 1,000mJ/cm ²	
最大卷材重量	50Kg	
最大卷材直徑	300mm	
應用	軟板卷對卷 - 單面板、雙面板、多層板	
設備大小	3.4m x 2.0m x 2.4m	

*取決於光阻特性

KLA 支持

保持系統生產力是 KLA 良率優化解決方案不可或缺的一部分。包括系統維護、全球供應鏈管理、降低成本和減少報廢、系統遷移、性能和生產率提升以及轉售認證設備。

KLA Corporation

www.orbotech.com/pcb | www.kla.com

Rev 5.0_3-31-2022

©2022 KLA 公司。所有品牌或產品名稱可能為其各自公司的商標。KLA 保留在不另行通知的情況下更改硬體和/或軟體規格的權利。